

DDR DIMM



打印日期 2024-05-29

优点

- ForTii® PA4T 在负荷下具备高刚性和高热变形温度 (HDT), 加之其回流焊后的出色低翘曲性及共面度, 能够轻松实现可靠性解决方案, 性能更优于液晶聚合物 (LCP) 和其他芳香族聚酰胺 (PPA); ForTii® 使 DDR 制造商能够通过减重减高生产更具成本效益的应用, 可在更低或更高的温度实现高可靠性, 在服务器中可以有效地减少聚热点, 使整个设备热管理效率最优化; ForTii® PA4T 碳足迹较低, 并使用不含卤素和红磷的阻燃剂, 能够实现可持续的解决方案



细节

ForTii® 使 DDR 制造商能够通过减高减重生产出更具成本效益的应用, 可在更低或更高的温度实现高可靠性, 在服务器中可以有效地减少聚热点, 使整个设备热管理效率最优化

产品

ForTii® Eco E11
PPA-GF30 FR(40)

ForTii® TX1
PPA-GF30 FR(40)

Stanyl® HFX61S
PA46-GF35 FR(40)

Stanyl® HFX82S
PA46-GF45 FR(40)

Stanyl® 46HF5145
PA46-GF43 FR

Stanyl® TE250F8
PA46-GF40 FR(17)



这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
 卖方独家声明并保证, 在卖方交付之日, 产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
 卖方对客户产品的设计不承担任何责任, 客户有责任确定卖方的产品是安全的, 符合应用法律和法规, 并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
 卖方不认可或声称其产品适合特定应用, 并且否认在这方面的每一项陈述或保证, 无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考, 不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分, 包括复印、记录或其他电子或机械方法。